

**HDC-C-HE-BM2.5AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Buchse, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 2.5, gedreht, Kupferlegierung
Best.-Nr.	<a href="#">1651500000</a>
Art	HDC-C-HE-BM2.5AU
GTIN (EAN)	4008190400170
VPE	100 ST

## HDC-C-HE-BM2.5AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

## Abmessungen und Gewichte

Durchmesser	4.5 mm	Nettogewicht	1.6 g
-------------	--------	--------------	-------

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Allgemeine Angaben

Kontaktdurchmesser Stift Ø	2.5 mm	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	7.5 mm
Anschlussart	Crimpanschluss	Ausführung Einsatz	HE, HEE, HQ, MixMate
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Gold
Steckzyklen	≥ 500	Typ	Buchse
Werkstoff	Kupferlegierung	Baureihe	HE
Herstellungsverfahren	gedreht	Oberflächen Schichtdicke, max.	1.25 µm
Oberflächen Schichtdicke, min.	0.75 µm	Leiteranschlussquerschnitt	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Werkstoff des Kontaktes	Kupferlegierung		

## Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## Zeichnungen

